

第3回材料研究会／九州・西日本支部合同研究会のご案内

各種高温超伝導体の商用生産が開始されるとともに、REBCOの応用・開発も進展してきました。一方で、磁気的な特性を用いた新たな応用や、材料設計、プロセスは、さらなる展開を見越し今後も重要な課題として取り組む必要があります。そこで本研究会では、REBCO高温超伝導体の材料設計、プロセス、応用をテーマに、多岐にわたる講師の先生方に講演していただきます。多くの皆様のご参加をお待ちしております。

なお、本研究会は材料研究会と九州・西日本支部の合同研究会として、オンサイトおよびオンラインのハイブリッド形式で開催します。また、支部の若手イベントと連日で開催し、現地で合同懇親会を行います。

テーマ： REBCO高温超伝導体の材料設計、プロセス、応用
日時： 2024年10月18日(金)
開催方法： ハイブリッド形式
場所： 高知工科大学永国寺キャンパス 教育研究棟 A105 教室
<https://www.kochi-tech.ac.jp/about/campus/eikokuji.html>
〒780-8515 高知県高知市永国寺町2番22号
及びZoom会場（オンライン） オンライン申込者には別途、会議用のURLをご案内します

プログラム：

13:30～13:35 開会の挨拶 材料研究会委員長 土井 俊哉（京都大学）
13:35～14:25 磁場配向法による希土類系高温超伝導体の二軸配向 堀井 滋（京都先端科学大学）
14:25～15:15 磁気シールドを志向した酸化物超伝導体の樹脂シートの作製 寺西 亮（九州大学）
15:15～15:30 休憩
15:30～16:20 ハイエントロピー合金の概念を取り入れた銅酸化物高温超伝導体の開発と機能性
山下 愛智（東京都立大学）
16:20～17:10 REBCO配向材料（薄膜、バルク）の簡便な作製手法、高機能化手法の開発
元木 貴則（青山学院大学）
17:10～17:15 閉会の挨拶 九州・西日本支部支部長 小田部 荘司（九州工業大学）

参加費： 資料代 3,000円（申込者には別途、資料の電子データをメールなどで配布します）

支払方法： PayPal（申込者には別途、支払い用のURLをお伝えします）

※PayPalによる支払いが困難な場合は銀行振込も対応できますので、その旨ご連絡ください

オーガナイザー： 船木 修平（島根大），木内 勝（九工大），寺西 亮（九大），
前田 敏彦（高知工大），井上 昌睦（福工大）

参加申込： 次のURLもしくは2次元コードから申込をお願いします

<https://forms.gle/8MWkfkHr9M8keaAA>

申込締切 9月27日(金)

問合せ先： 船木 修平 E-mail：s-funaki@riko.shimane-u.ac.jp

Tel：0852-32-6406



研究会翌日に開催予定の九州・西日本支部若手イベントへも奮ってご参加ください（別途、会告案内あり）